

性能特点：

- 频带：1~2.35GHz
- 噪声系数： $\leq 2\text{dB}$ (1.3GHz-2.3GHz)
- 增益：15dB-17dB 增益平坦度： $\leq \pm 0.7\text{dB}$
- 输入/输出驻波比：1.5/1.5
- 输出 P1dB： $\geq 13\text{dBm}$
- 带外抑制：5dBc (3GHz-6GHz)
- 电源供电： $+5\text{V}@ \leq 60\text{mA}$
- 芯片尺寸：2.2mm \times 1.8mm \times 0.1mm

产品简介：

HH-MF8103 是一款 GaAs MMIC 放大滤波多功能芯片，其频率范围覆盖 1~2.35GHz，整个带内噪声系数典型值为 2dB。HH-MF8103 采用 +5V 供电。

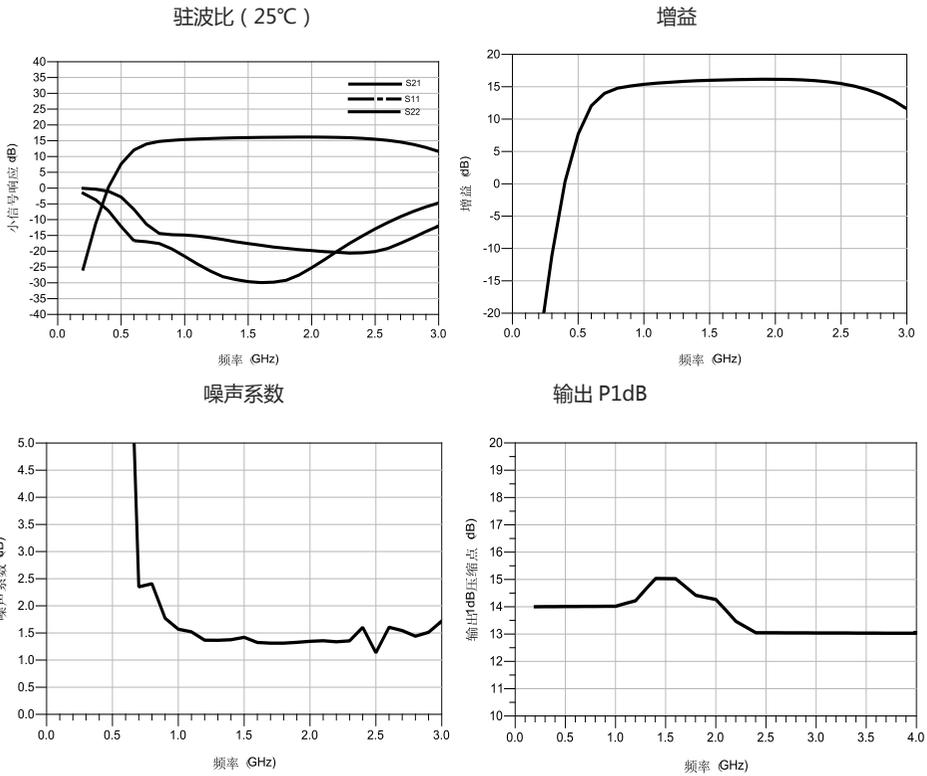
电参数： ($T_A=25^\circ\text{C}$, $V_d=+5\text{V}$)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	1~2.35			GHz
噪声系数	1.3	-	2	dB
增益	15	-	17	dB
输出 P1dB	13	-	-	dBm
输入驻波比	-	1.5	-	-
输出驻波比	-	1.5	-	-

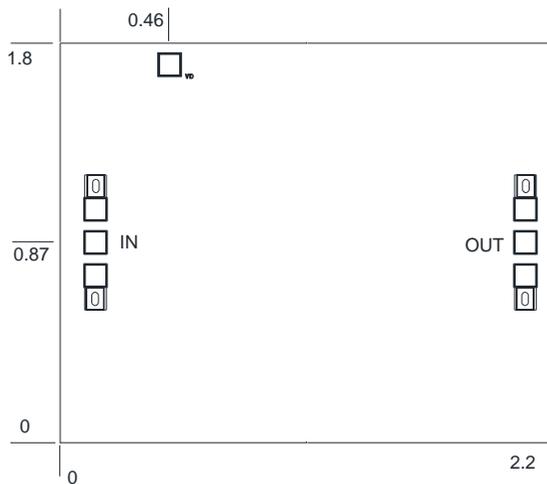
使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

输入功率	+23dBm
控制电压	+9V
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

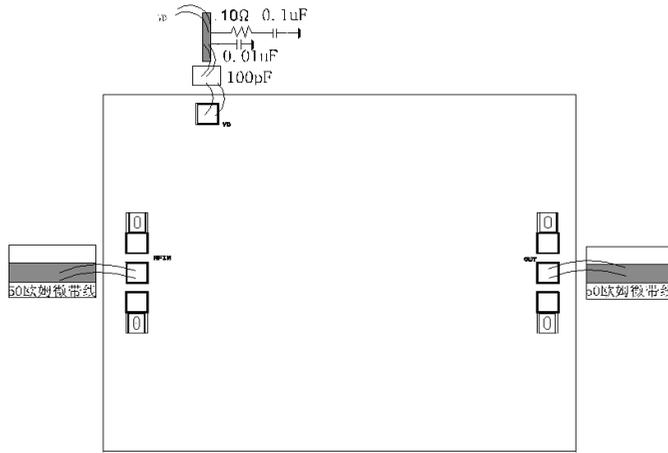
典型曲线：



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

注意事项：输入输出有隔直电容

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）